

# LRF-gun meeting

2009/07/06 ミーティング資料  
16:00～

Shigeru KASHIWAGI (ISIR, Osaka Univ.)

---

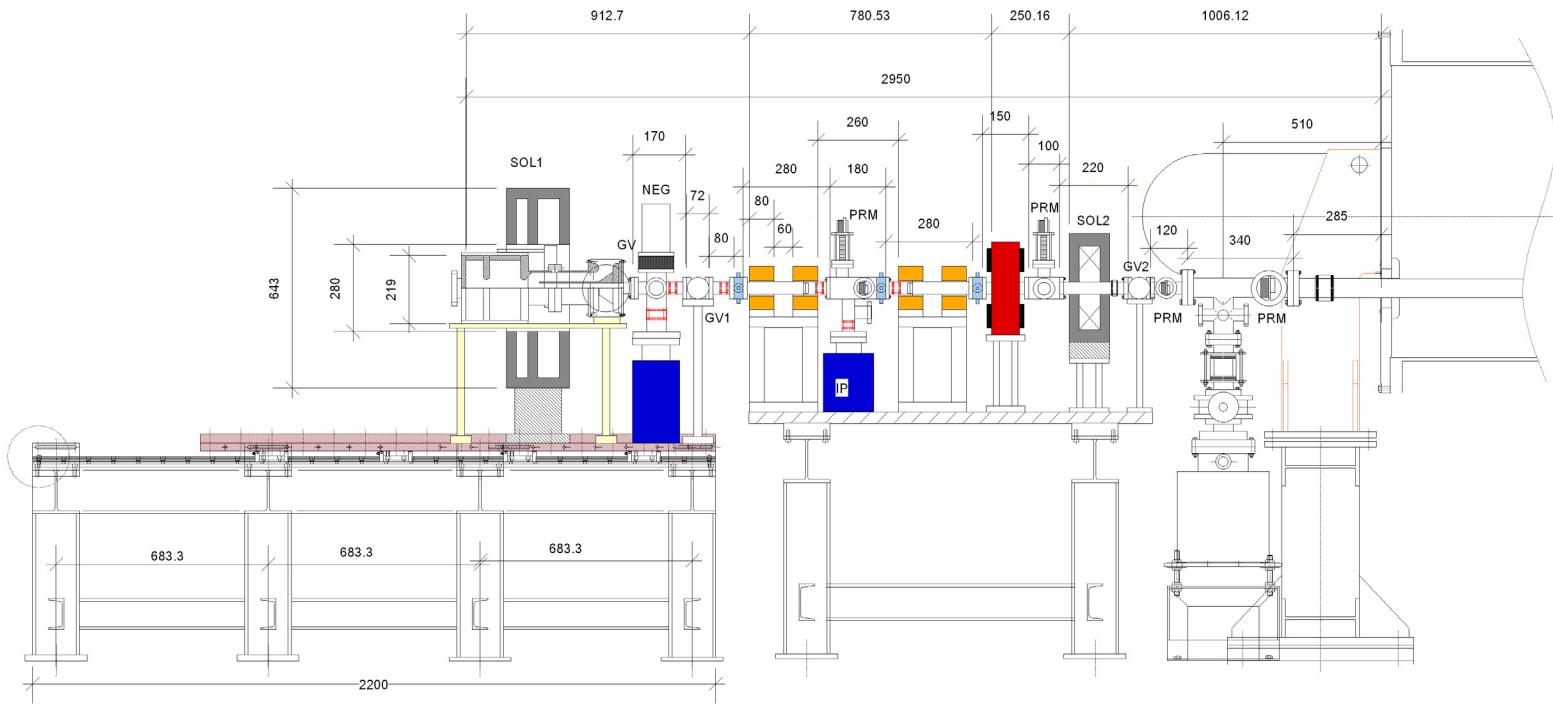
STFビームライン計算 with Chicane

空洞製作について(予備)

# STFビームライン

## 基本構成

RF-gun → Solenoid-1 → Chicane(4-rect. dipole)@0.91  
→ Quadrupole@1.69 → Solenoid-2@1.94 → 1.8m-long-drift  
→ SCcavity-1@3.75 → SCcavity-2@5.35



SC空腔はクライオモジュール上流端面から0.81mの位置とした。

# パラメータ

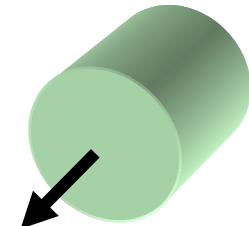
GPTを使って計算を行った。韓国人のポスドクの方が行ったPALMELAでの計算結果と大雑把に比較するために初期電子分布などは同じ。

初期電子分布: (settdist コマンドを使用、時間の経過と共にカソードから電子が発生)

Transverse: Round shape & Uniform ( $r = 1.5 \text{ mm}$ )

Longitudinal: Uniform (20ps)

$Q = 3.2\text{nC}$



RF-gun & Solenoid:

- ・RF-gun電場勾配: max  $\sim 41.4 \text{MV/m}$
- ・バッキングコイル一体型

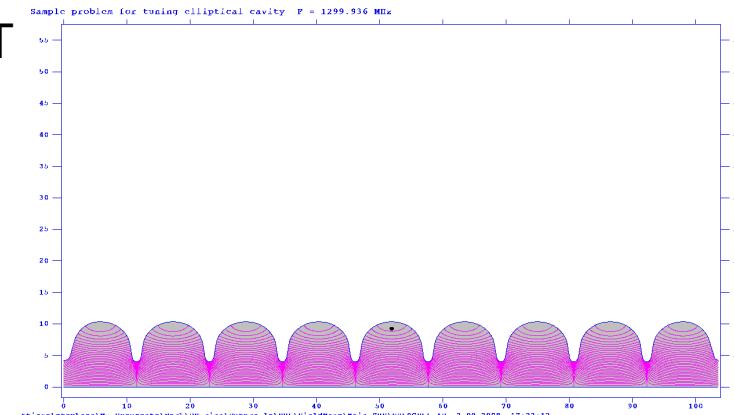
Chicane: 矩形型4台(1つの磁極長80mm、磁石間距離60mm)

Quad: 磁極長100mm, Gradient  $\sim 0.5 \text{T/m}$

Solenoid-2: ボア径76mm、150mm厚、 $B_z \sim 0.13 \text{T}$

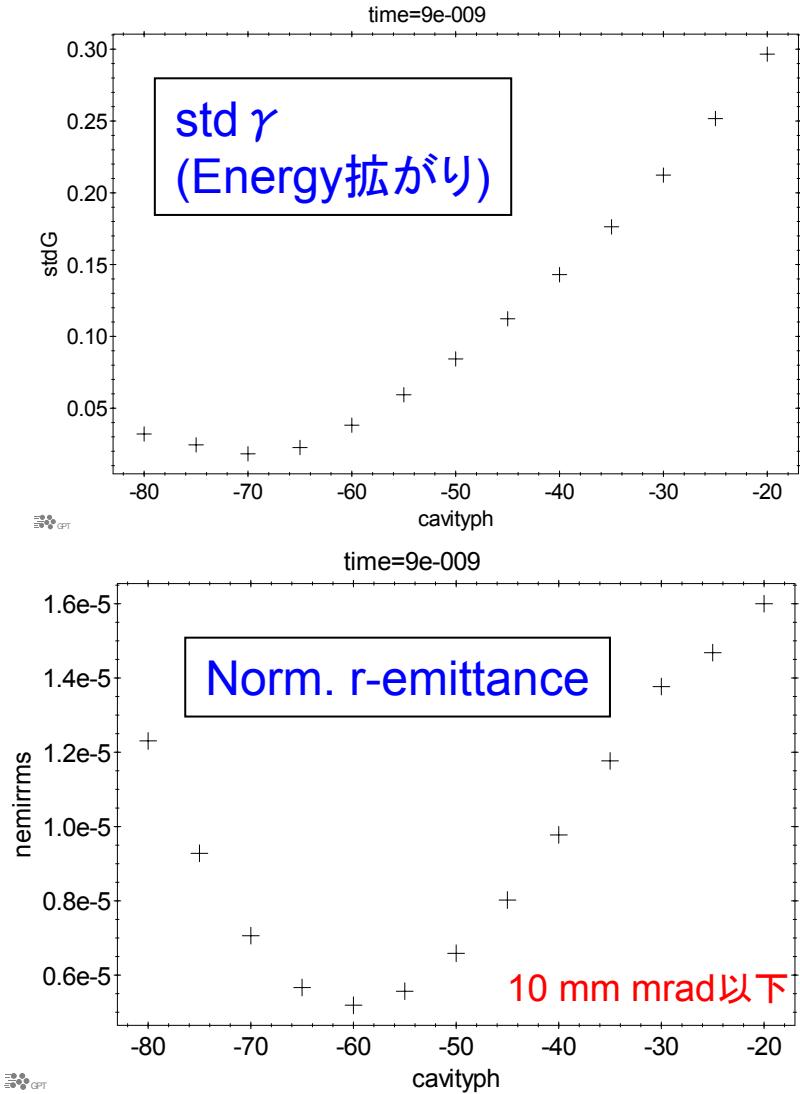
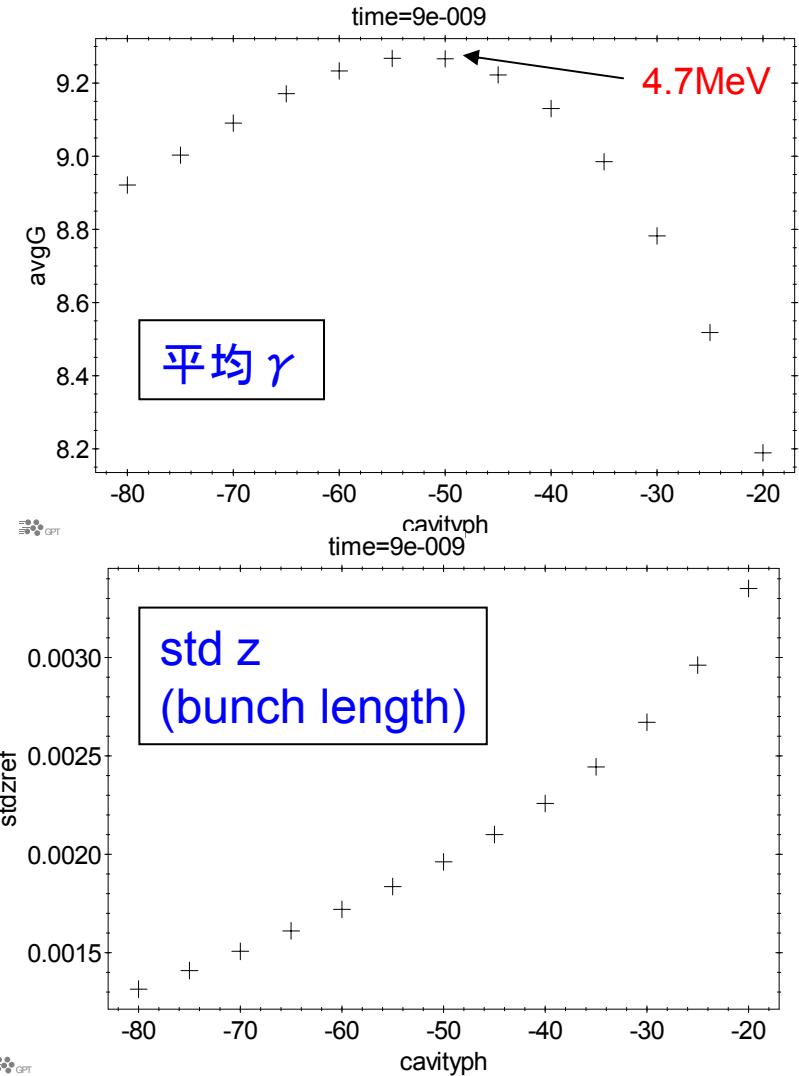
SC空洞:

- ・ERLメイン部用の9cell空洞
- ・加速電場勾配: max  $\sim 15.2 \text{MV/m}$
- ・SC1とSC2の間の距離は60cmとした。



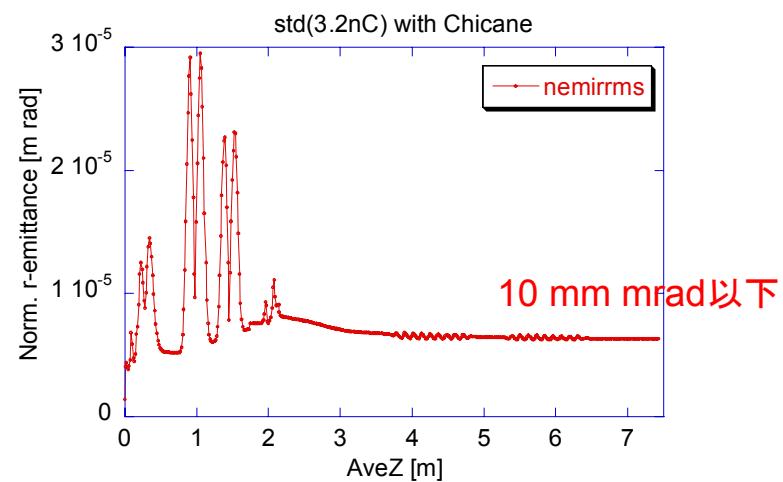
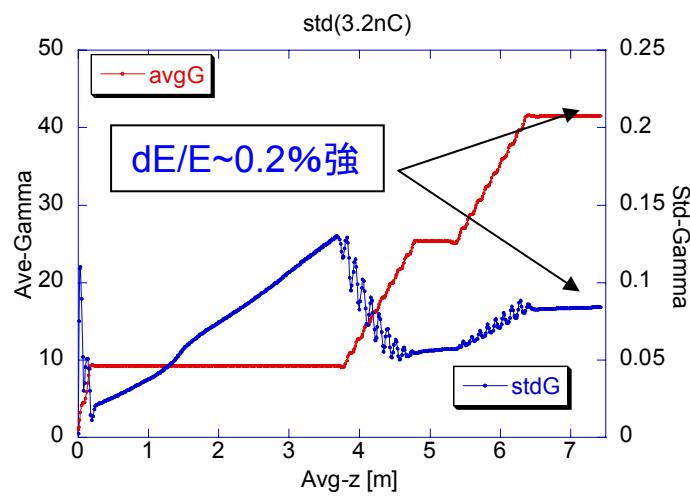
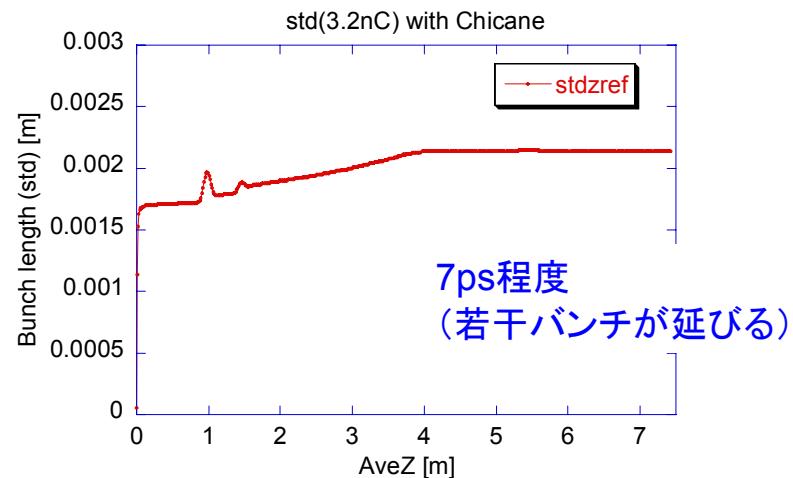
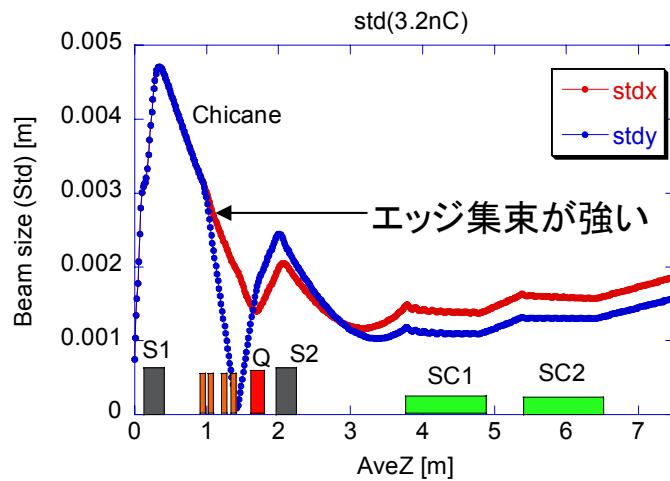
# LRF-gun出力(3.2nC)

まず最初に、電子銃出力ビームをドリフト約2.5mを通過させた時のビーム特性。  
RF電子銃のRF位相を変化させた場合。



# SC2下流(3.2nC)

カソードから7.5m下流(SC2下流)までビームを加速した時のビームラインに沿ったパラメータ変化。最終ビームエネルギー~21.5MeV



パラメータサーチは半分手動。シケインの非対称な集束を補正するのに、Sol2の部分をQ-magのトリプレットにする事も検討。レーザーがきれいな円柱ビームを生成できるかが課題？。

# LRF-gun空洞製作について

## 方針を決めるにあたっての検討事項…

### 1. 空洞形状

- 内形状
- 外形状(冷却配管、空洞ボリューム)

### 2. 空洞製作方法・材料

- 空洞内面の表面粗さ (鏡面加工、ダイヤモンド切削)
- 口ウ付け (真空炉、水素炉)
- 銅材料 (HIP[Hot Isostatic Pressing]処理)

### 3. その他

- RFモニター (空洞に取り付ける、導波管の結合器を利用)
- 結合器(導波管)

# 空洞形状

## ● 内形状 (とりあえず1.5 cellとして)

### 1. BNL-type

- フルセルからRF供給、セルの2b部が直角

### 2. DESY-type

- 同軸結合、セルの2b部にRがとつてある(Qが10%増)

### 3. Round shape (Large mode separation)

- Abhey案: 加工が難しい

- S-bandの空洞には有効:  $\Delta F(L) \sim 5\text{MHz}$ ,  $\Delta F(S) \sim 3.5\text{MHz}$ ?

- Abhey空洞のビーム試験結果; 2009年度内

## ● 外形状

### 1. 空洞冷却

- 冷却配管取り回し、カソード面・ビーム出力側壁の冷却の改良

### 2. 空洞全体のボリューム(肉厚)をアップ

- 熱容量を増やす、全体を銅で製作? (空洞外壁、ディスク内部)

- チューナースペースを確保?

# 空洞製作方法・材料

## 1. 切削加工

現在製作中のFNAL空洞の表面粗さは、図面から RA=0.2mm  
普通旋盤での加工だと思われる。

最近は、通常加工機でも寸法精度は数  $\mu\text{m}$ までいける。

超精密加工機(単結晶のダイヤモンドバイト) RA=50nm (高富氏)

## 2. 口ウ付け

炉の選択。(分からぬことが多い)

真空炉:  $10^{-5}\text{ Pa}$ 程度の真空(ナイスは多分真空炉)

水素炉: 焼きなましが必要? 結晶欠陥に水素が入り込む。  
(KEKでSRF-gunを口ウ付けした炉は水素炉)

## 3. 材料

無酸素銅のHIP材: ATF S-band加速管の一部のディスクがHIP処理材を使用されている。材料の質が向上したので、最初の数本の加速管以外はHIP処理無しのクラス I の無酸素銅。(三菱重工三原の担当者談)

\*SRF-gunはHIP材を使用。

加工法、材料を変えるだけでも暗電流削減が期待できる。

# その他

## 1. RFモニター

- ・空洞になんとかアンテナを付ける場所を確保する。ビーム出力側壁が一つの候補か？ 発熱、放電、暗電流の種になりやすいので注意。
- ・導波管の方向性結合器でモニターできないか？ フィードフォワード

## 2. 結合器

- ・ドアノブ形状の改良：内導体径の拡大
- ・ショート面位置・形状の改良

## 3. 図面

日本で空洞を製作するにあたり、FNALの図面を使わせてもらうことについてSelgei氏に確認済み。DESY-FNAL間がどうなっているかは不明。KEKで8月末を目標に図面をおこす。(外注もあり)